

請求の範囲

- [請求項1] 電子部品を実装するエンボスキャリアテープ用の導電性シートであって、
- 該導電性シートは、コア層の少なくとも片面に導電性を有する表面層が積層された構成をなし、
- 前記コア層及び前記表面層は、それぞれ、スチレンーブタジエン共重合体樹脂と、汎用ポリスチレン樹脂と、耐衝撃ポリスチレン樹脂の3種のポリスチレン系樹脂の組合せのみから構成される共通材料を備え、
- 前記コア層を構成する共通材料と、前記表面層を構成する共通材料とは、配合比率が同じであり、
- 前記表面層は、前記共通材料にカーボンブラックを混練して構成されており、
- 前記共通材料の配合比率は、該共通材料全体を100重量%とするときに、前記スチレンーブタジエン共重合体樹脂が35重量%、前記耐衝撃ポリスチレン樹脂が10重量%～15重量%であることを特徴とする導電性シート。
- [請求項2] 電子部品を実装するエンボスキャリアテープ用の導電性シートであって、
- 該導電性シートは、コア層の少なくとも片面に導電性を有する表面層が積層された構成をなし、
- 前記コア層及び前記表面層は、それぞれ、スチレンーブタジエン共重合体樹脂と、汎用ポリスチレン樹脂と、耐衝撃ポリスチレン樹脂の3種のポリスチレン系樹脂の組合せのみから構成される共通材料を備え、
- 前記コア層を構成する共通材料と、前記表面層を構成する共通材料とは、配合比率が同じであり、
- 前記表面層は、前記共通材料にカーボンブラックを混練して構成さ

れており、

前記共通材料の配合比率は、該共通材料全体を 1 0 0 重量%とするときに、前記スチレン-ブタジエン共重合体樹脂が 3 5 重量%、前記耐衝撃ポリスチレン樹脂が 1 0 重量%～1 5 重量%、前記汎用ポリスチレン樹脂が 5 0 重量%～5 5 重量%であることを特徴とする導電性シート。

[請求項3]

請求項 1 又は請求項 2 のいずれかに記載の導電性シートにエンボスポケットを加工成型して成るエンボスキャリアテープ。